

取付基板加工寸法 (適用基板厚 1.6)

注: ハッチ加工の場合、基板の
穴の径は穴径に対して穴径
(2加工径を)

加工径	穴径	加工径	穴径
1.1 ± 0.05	0.9 ± 0.1	1.1 ± 0.05	0.9 ± 0.1

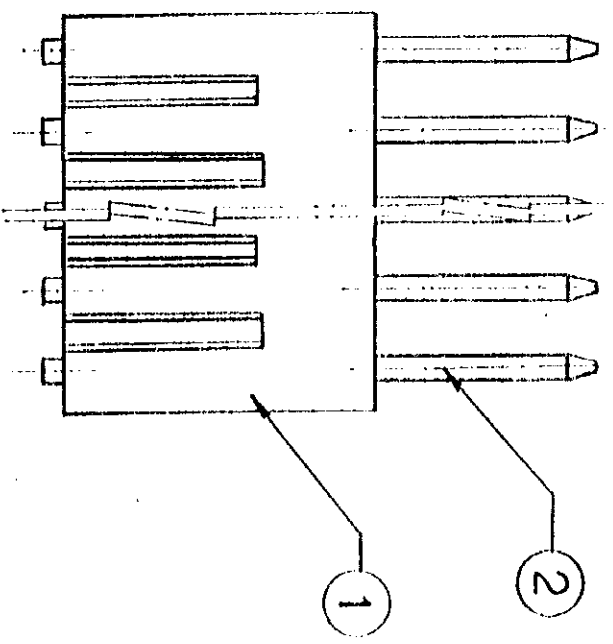
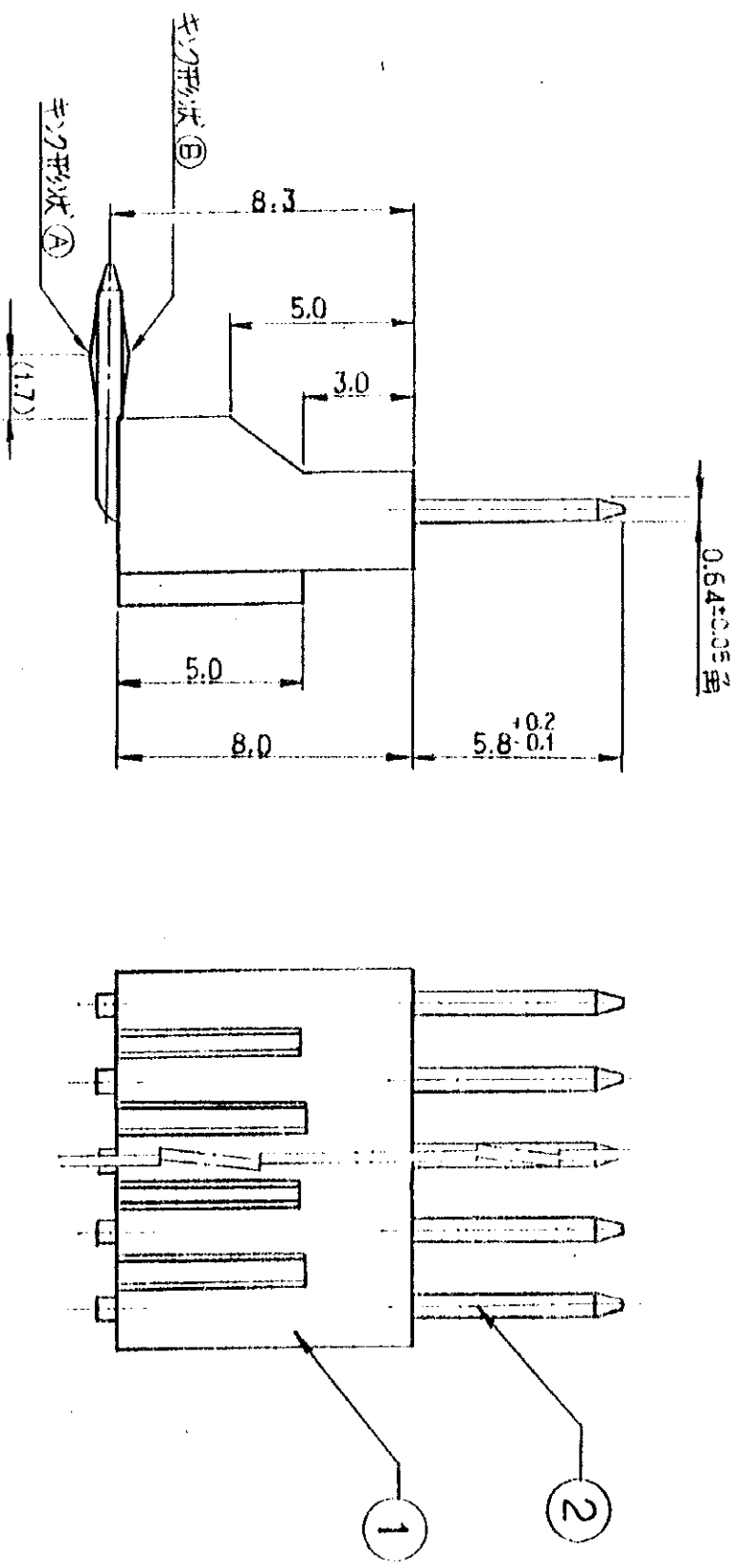


表2: 材料・表面処理

名	材	材	材
①	ハッチ加工	6/6加工 (UL94V-0)	
②	ポストコート	半田めっき	要銅

表1: キリ加工位置方向

回路No	1	2	3	4	5	6	7	8	9
種数	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)	(A)	(B)

単位: ㎜ DIMENSIONS IN MM. DO NOT SCALE PRINT

PRINT DIST

AMP-J-030-2
REV. 9/83

LTR	作成	J-10469	DR	CHK	DATE
	変更 (REVISION RECORD)				

© 19 年 日本エー・エル・ピー株式会社 AMP社の特許品は特許文は特許法第17条第1項第1号に規定する。	© 19 BY AMP (Japan) LTD. ALL RIGHTS RESERVED. AMP PRODUCTS COVERED BY PATENTS AND OR PATENT'S PENDING	適合電線断面径 (WIRE RANGE) mm (AWG)	適合絶縁径 (INSULATION DIA) mm	材料 (MATERIAL) 表2 参照	加工 (FINISH)	公差 (TOLERANCE)	穴径 (LOC)	穴径 (NO.)	穴径 (NO.)	穴径 (NO.)
		8mm 9/16"	2.0mm 2.0"			± 0.2	B	J	C-175544	

AMP 日本エー・エル・ピー株式会社
TOKYO, JAPAN

(CUSTOMER DRAWING) 参 考 図 面